

## 深圳佰维存储科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录汇总表

(2024年12月5日)

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 专场机构交流会 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	青朴资本 严朴、浙江诚合资管 蒋开申、深圳磐石投资 罗振轩、深圳前海云溪 阳勇、东兴证券 罗建军、同威投资 冯翔、深圳海衍投资 丁威
<b>会议时间</b>	2024年12月5日 15:00-16:00
<b>会议地点</b>	佰维存储三楼会议室
<b>上市公司接待人员姓名</b>	战略部总监兼投资者关系负责人 肖博天 董办工作人员
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p><b>Q1. 公司自成立之初就自建封测产能，请介绍下公司的制造管理系统？</b>            A1: 公司通过整合产品生命周期管理系统、产品设计开发系统、质量管理体系、仓库管理系统、生产信息化管理系统、产品更改通知管理系统、交付系统，将制造过程与采购、研发、交付等相关环节进行紧密协同，实现产品制造与交付的信息化，形成了产品全生命周期的数据管理体系，且通过生产测试数据的自动化采集和分析，构建了智能化的制造体系。公司通过芯片封装设备、模组制造设备以及测试设备系统的一体化智能联机运行，实现高度自动化及制造过程的全程可追溯性。</p> <p><b>Q2. 目前 DDR5 的渗透率情况如何？公司是否有布局相关产品？</b>            A2: 据 TrendForce 预测，DDR5 渗透率在 2024 年第三季度将突破 50%。在嵌入式存储领域，公司产品已涵盖 LPDDR5/5X，并已布局 12GB、16GB 等大容量 LPDDR 产品；最新一代 LPDDR5/5X 相比于 LPDDR4/4X 产品，将对下一代便携电子设备的性能产生巨大提升，目前已面向市场稳定供应。在 PC 存储领域，公司已正式发布 DDR5 内存模组，其中超频内存条传输速率最高可达 8,200Mbps，满足 PC 对极致性能的追求，并支持数据纠错机制、智能电源管理等功能。</p> <p><b>Q3. 公司有哪些产品可以用在工业市场？</b>            A3: 公司面向汽车电子应用与工业场景打造了子品牌“佰维特存”，为汽车与工业领域的客户带来高附加值的存储解决方案。公司从介质特性研究、硬件设计、固件算法开发测试验证、存储芯片先进封测到稳定供应链、全周期客户服务，构建了全方位的存储解决方案体系，打造高可靠性、高稳定性的全品类工</p>

业级存储产品。公司工业级产品分为-20°C~70°C的工业标准级、-40°C~85°C的工业宽温级两大类，包括工业级 eMMC、UFS、LPDDR、SSD、内存模组、存储卡等产品，能够应用于通信基站、智能汽车、智慧城市、工业互联网、高端医疗设备、智慧金融等领域。

**Q4. 公司目前已进入哪些智能可穿戴领域的客户？未来，公司在可穿戴市场如何保持竞争优势？**

A4：公司在智能穿戴领域目前已进入 Google、Meta、小米、小天才等知名企业，产品应用于其智能手表、智能眼镜等。基于公司研发封测一体化的布局，公司存储器产品在智能可穿戴领域具有较强的竞争优势，能够在低功耗、快响应等方面进行固件算法优化设计的同时，通过先进封测工艺能力，助力产品的轻薄小巧。此外，公司自研主控也将进一步增强公司产品在穿戴领域的竞争力，目前已通过了某头部客户的初步选型，比较优势得到客户认可。未来，公司将在智能穿戴市场持续投入战略性资源，力争成为主要参与者。

**Q5. 如何展望存储行业的长期发展趋势？**

A5：下一代信息技术与存储器技术发展密不可分。物联网、大数据、人工智能、智能车联网、元宇宙等新一代信息技术既是数据的需求者，也是数据的产生者。同时，AI 技术革命将大大提升对高端存储器的需求。据全球知名市场研究机构 Yole 发布的报告显示，得益于数据中心、云计算和 5G 等行业的持续增长以及全球半导体供应链的逐步恢复，2027 年存储市场空间预计增长至 2,630 亿美元。目前存储器国产化率较低，存储芯片的国产化率将随着市场和政策的双向推动大幅提升，国产存储产业前景广大。

**Q6. 如何展望车载存储市场的未来空间以及公司目前有哪些布局？**

A6：据 Yole 数据显示，2027 年车载存储市场规模达到 125 亿美元，2021-2027 年 CAGR 为 20%。公司已经推出了涵盖 eMMC、UFS、SPI NOR、LPDDR、BGA SSD、存储卡在的全面车规存储产品矩阵，系列产品支持 -40°C~105°C 宽温工作环境，并满足 AEC-Q100 车规级可靠性标准，覆盖多种容量等级。公司车规存储相关产品已在国内头部车企及 Tier1 客户量产。公司将投入战略性资源，力争成为车规存储市场的主要参与者。

**Q7. 公司在消费级 PC 领域的产品有什么优势？消费级产品客户覆盖面如何？**

A7：公司的 PC 存储包括固态硬盘、内存条产品，主要应用于电竞主机、台式机、笔记本电脑、一体机等领域。公司 PC 存储具有高性能、高品质的特点，并具备创新的产品设计。公司固态硬盘产品传输速率最高可达 7,450MB/s，处于行业领先地位，并支持数据纠错、寿命监控、异常掉电保护、数据加密、端到端数据保护、功耗监测及控制等功能。客户方面，在 PC 预装市场，公司自主品牌佰维（Biwin）进入了惠普、联想、宏碁等知名 PC 厂商区域市场供应链。在 PC 后装市场，公司双向发力，一方面运营公司自主品牌佰维（Biwin），主要在京东、抖音等线上零售平台销售，以及通过与代理商合作开发线下渠道市场；另一方面独家运营的惠普（HP）、宏碁（Acer）、掠夺者（Predator）等授权品牌，主要在京东、亚马逊等线上平台，以及 Best

	<p>Buy、Staples 等线下渠道开发 To C 市场。</p> <p><b>Q8. 目前公司晶圆级先进封测项目正在建设中，请问是否已经构建了相关的技术团队以及团队背景介绍。</b></p> <p><b>A8:</b> 公司已组建完整的、国际化的专业晶圆级先进封测技术、运营团队。项目负责人拥有近 20 年国际一流半导体公司运营管理经验，曾主持建立了国内首批 12 英寸晶圆级先进封装工厂并实现稳定量产。项目核心团队具备成熟研发和量产经验，熟练掌握晶圆级先进封测核心技术。</p>
<b>附件清单</b>	无
<b>日期</b>	2024 年 12 月 5 日
<b>备注</b>	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。